

中国先进封装行业发展深度分析与投资前景预测 报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国先进封装行业发展深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202607/807331.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

先进封装是超越传统封装的高阶技术，其核心在于通过晶圆级封装、异构集成、堆叠互联等方式，将多颗功能不同的芯片集成在一个封装体内，实现系统级的功能整合，从而提升性能、缩小体积。

1、中国先进封装产业链结构

产业链来看，我国先进封装行业产业链上游为晶体材料、封装材料及封装设备，封装材料包括封装基板、键合材料、引线框架等，设备包括光刻机、刻蚀机等；中游为封装制造与测试，封装为倒装芯片封装、2.5D/3D封装、Chiplet技术等，测试分为电性测试、老化测试等；下游为终端应用领域，应用于传感器、半导体功率器件、半导体分立器件、模拟电路、储存芯片等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

产业链全景来看，我国先进封装产业链涵盖上游材料与设备、中游先进封装制造与测试、下游应用三大环节。

我国先进封装产业链上中下游结构全景

产业链环节

细分领域

代表性产品/技术

国产化率

代表企业

上游一封装设备

键合设备

引线键合/倒装键合/混合键合

<5%

奥特维、佳源科技

检测设备

晶圆检测/3D X-ray/AOI

<10%

华峰测控、长川科技

减薄/划片

晶圆减薄机/激光划片

<15%

中电科45所/大族激光

上游-封装材料

封装基板

ABF/BT载板/玻璃基板

<10%

深南电路/兴森科技

包封/粘结

环氧塑封料/底部填充胶

30%

华海诚科/德邦科技

键合丝/凸块

金丝/铜丝/锡球

50%

康强电子/烟台一诺

中游-先进封装

2.5D封装中

硅中介层/CoWoS-like

量产中

长电科技/通富微电

3D 封装

TSV/Hybrid Bonding

产线通线

长电科技/华天科技

扇外型封装

FOWLP/FOPLP

量产中

华天科技/晶方科技

系统级封装SiP

多芯片模组集成

量产中

长电科技/甬矽电子

下游-应用

AI/HPC 芯片

GPU/CPU/ASIC

>90%

英伟达/AMD/寒武纪

存储芯片

HBM/DRAM/NAND

>90%

长鑫存储/长江存储

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、上游代表性企业

我国先进封装上游产业已覆盖基板、材料、设备等关键环节。基板领域，深南电路为国内龙头，BT基板量产、ABF基板爬坡；兴森科技为国内唯一ABF载板量产企业，订单增长显著。材料方面，生益科技领跑ABF膜国产替代，华海诚科塑封料已进入长电供应链，宏昌电子配套开发新型树脂。设备领域，迈为股份布局混合键合，拓荆科技临时键合设备进入客户验证，国产装备加速突破。

我国先进封装行业上游代表性企业

类别

企业简称

企业地位

核心能力

封装基板

深南电路

国内封装基板龙头，无锡/广州基地

BT基板量产，ABF基板爬坡，Q3存储类基板增长最显著

兴森科技

国内唯一ABF载板量产上市企业

FCBGA项目投资38亿元+，2025H1样品订单超2024全年

封装基板材料

生益科技

覆铜板龙头，ABF膜国产替代先锋

ABF膜送样验证中，配合下游载板客户推进

ABF 树脂

宏昌电子

环氧树脂龙头

配合下游开发ABF载板用新型树脂体系

封装材料

华海诚科

环氧塑封料国产替代主力

已进入长电科技供应链，先进封装塑封料在验证

键合设备

迈为股份

异质结设备龙头，布局混合键合

混合键合设备在研，已获部分客户关注

拓荆科技

薄膜沉积设备龙头，布局临时键合

临时键合设备进入客户验证阶段

资料来源：公开资料、观研天下整理

3、中游代表性企业

我国先进封装中游以长电科技（359.6亿元）、通富微电（238.8亿元）、华天科技（144.6亿元）为三大龙头，分别覆盖2.5D/3D/SiP、Chiplet及Panel-Level等技术路线，产能布局国内外。细分领域，晶方科技专注CIS晶圆级封装并拓展汽车电子，甬矽电子Q1扭亏增长迅猛，顾中科技领跑显示驱动封测，伟测科技为第三方测试龙头，气派科技正从传统封装向先进封装转型。整体形成龙头引领、专精特新企业协同发展的格局。

企业简称	2024年营收	技术线路	产能规划与布局
长电科技	359.6亿元	2.5D/3D/SiP/FO	2026年固投100亿元；江阴/上海/宿迁/韩国/新加坡
通富微电	238.8亿元	2.5D/FO/Chiplet	35.2亿先进封测项目；南通/苏州/合肥/槟城
华天科技	144.6亿元	2.5D/FO/Panel-Level	天水/西安/昆山/南京/Unisem 五大基地，2.5D产线建成
晶方科技	12亿元	WLCSP/FO CIS晶圆级封装	封装龙头，向汽车电子方向拓展
甬矽电子	9亿元+	SIP/FO	先进封装新锐，Q1营收增30.12%实现扭亏
顾中科技	约15亿元	凸块/COF	显示驱动芯片封装龙头，12吋凸块量产
伟测科技	约8亿元	晶圆测试/成品测试	第三方测试龙头，先进制程测试占比提升
气派科技	约5亿元	DFN/QFN/FC	分立器件与电源管理封装，布局先进封装

资料来源：公开资料、观研天下整理

4、新兴力量与装备代表性企业

我国先进封装新兴力量与装备领域多点突破。新兴力量方面，华封集芯融资3亿元，2.5D/3D产线建设中；物元半导体2025年产能大举释放。装备与材料方面，华峰测控模拟测试机全球领先，长川科技数字测试机获龙头批量订单；中电科45所12英寸减薄机完成验证；沃格光电TGV玻璃基板规划产能世界第一；华大九天与概伦电子作为国产EDA双龙头，积极布局先进封装设计工具，国产配套能力正加速提升。

我国先进封装行业新兴力量与装备代表性企业类别

企业简称

企业地位

核心能力

Chiplet创企

华封集芯

北京先进封装链主企业，融资3亿元

2.5D/3D 产线建设中，23亿元银团贷款签约

物元半导体

先进封装项目于2025年产能大举释放

布局高端封装

测试设备

华峰测控

模拟测试机全球领先

STS8200/8300系列覆盖全部封测类型

长川科技

数字测试机+分选机龙头

获国内封测龙头批量订单

减薄划片

深中电45所步

晶圆减薄/划片设备国家队

12吋减薄机完成验证

玻璃基板

沃格光电

TGV玻璃基封装载板

规划产能世界第一

EDA工具

华大九天/概伦电子

国产EDA双龙头

先进封装设计工具布局中

资料来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局

、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国先进封装行业发展深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计局部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）

报告主要图表介绍

图（部分）

表（部分）

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量

PEST模型分析结论

2025年行业成本结构情况

行业所属行业企业数量分析

2021-2025年行业平均价格走势

行业所属行业资产规模分析

2021-2025年行业毛利率走势

行业所属行业流动资产分析

2021-2025年行业细分市场1市场规模

行业所属行业销售规模分析

2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测

行业所属行业负债规模分析

2021-2025年行业细分市场2市场规模

行业所属行业利润规模分析

2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测

所属行业产值分析

2021-2025年全球行业市场规模

所属行业盈利能力分析

2025年全球行业区域市场规模分布

所属行业偿债能力分析

2021-2025年亚洲行业市场规模

所属行业营运能力分析

2026-2033年亚洲行业市场规模预测

所属行业发展能力分析

2021-2025年北美行业市场规模

企业1营业收入构成情况

2026-2033年北美行业市场规模预测

企业1主要经济指标分析

2021-2025年欧洲行业市场规模

企业1盈利能力分析

2026-2033年欧洲行业市场规模预测

企业1偿债能力分析

2026-2033年全球行业市场规模分布预测

企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模
企业3主要经济指标分析
2026-2033年华北地区行业市场规模预测
企业3盈利能力分析
2021-2025年东北地区行业市场规模
企业3偿债能力分析
2026-2033年东北地区行业市场规模预测
企业3运营能力分析
2021-2025年西南地区行业市场规模
企业3成长能力分析
2026-2033年西南地区行业市场规模预测
企业4营业收入构成情况
2021-2025年西北地区行业市场规模
企业4主要经济指标分析
2026-2033年西北地区行业市场规模预测
企业4盈利能力分析
2026-2033年行业市场分布预测
企业4偿债能力分析
2026-2033年行业投资增速预测
企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图

企业6营业收入构成情况

.....

.....

图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 先进封装

第一节 先进封装

一、先进封装

二、先进封装

三、先进封装

四、先进封装

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国 先进封装

第三节 中国 先进封装

第二章 中国 先进封装

第一节 中国 先进封装

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国 先进封装

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对 先进封装

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 中国	先进封装
第一节 中国宏观经济发展现状	
第二节 中国对外贸易环境与影响分析	
第三节 中国	先进封装
一、PEST模型概述	
二、政策环境影响分析	
三、经济环境影响分析	
四、社会环境影响分析	
五、技术环境影响分析	
第四节 中国	先进封装
第四章 全球	先进封装
第一节 全球	先进封装
第二节 全球	先进封装
一、2021-2025年全球	先进封装
二、全球	先进封装
第三节 亚洲	先进封装
一、亚洲	先进封装
二、2021-2025年亚洲	先进封装
三、亚洲	先进封装
第四节 北美	先进封装
一、北美	先进封装
二、2021-2025年北美	先进封装
三、北美	先进封装
第五节 欧洲	先进封装
一、欧洲	先进封装
二、2021-2025年欧洲	先进封装
三、欧洲	先进封装
第六节 2026-2033年全球	先进封装
第七节 2026-2033年全球	先进封装
【第三部分 国内现状与企业案例】	
第五章 中国	先进封装
第一节 中国	先进封装
一、	先进封装
二、	先进封装
第二节 中国	先进封装

一、影响中国	先进封装
二、2021-2025年中国	先进封装
三、中国	先进封装
第三节 中国	先进封装
一、2021-2025年中国	先进封装
二、中国	先进封装
第四节 中国	先进封装
一、2021-2025年中国	先进封装
二、中国	先进封装
第五节 中国	先进封装
第六章 中国	先进封装
第一节 中国	先进封装
第二节	先进封装
一、	先进封装
二、	先进封装
三、2021-2025年中国	先进封装
第三节	先进封装
一、	先进封装
二、	先进封装
第四节 中国	先进封装
一、需求偏好	
二、价格偏好	
三、品牌偏好	
四、其他偏好	
第五节 中国	先进封装
第七章 中国	先进封装
第一节 中国	先进封装
一、产业链模型原理介绍	
二、产业链运行机制	
三、	先进封装
第二节 中国	先进封装
一、上游产业发展现状	
二、上游产业对	先进封装
三、下游产业发展现状	
四、下游产业对	先进封装

第三节 中国 先进封装

一、中国 先进封装

二、细分市场分析——市场1

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

三、细分市场分析——市场2

1.2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）

第八章 中国 先进封装

第一节 中国 先进封装

一、中国 先进封装

二、中国 先进封装

第二节 中国 先进封装

一、中国 先进封装

二、中国 先进封装

第三节 中国 先进封装

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第四节 中国 先进封装

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第九章 中国 先进封装

第一节 中国 先进封装

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国 先进封装

一、流动资产

二、销售收入分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析	
三、华北地区	先进封装
1、2021-2025年华北地区	先进封装
2、华北地区	先进封装
3、2026-2033年华北地区	先进封装
第六节 东北地区市场分析	
一、东北地区概述	
二、东北地区经济环境分析	
三、东北地区	先进封装
1、2021-2025年东北地区	先进封装
2、东北地区	先进封装
3、2026-2033年东北地区	先进封装
第七节 西南地区市场分析	
一、西南地区概述	
二、西南地区经济环境分析	
三、西南地区	先进封装
1、2021-2025年西南地区	先进封装
2、西南地区	先进封装
3、2026-2033年西南地区	先进封装
第八节 西北地区市场分析	
一、西北地区概述	
二、西北地区经济环境分析	
三、西北地区	先进封装
1、2021-2025年西北地区	先进封装
2、西北地区	先进封装
3、2026-2033年西北地区	先进封装
第九节 2026-2033年中国	先进封装
第十一章	先进封装
第一节 企业1	
一、企业概况	
二、主营产品	
三、运营情况	
1、主要经济指标情况	
2、企业盈利能力分析	
3、企业偿债能力分析	

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国 先进封装

第一节 中国 先进封装

第二节 2026-2033年中国 先进封装

第三节 2026-2033年中国 先进封装

一、2026-2033年中国 先进封装

二、2026-2033年中国 先进封装

三、2026-2033年中国 先进封装

第四节 2026-2033年中国 先进封装

一、2026-2033年中国 先进封装

二、2026-2033年中国 先进封装

第五节 2026-2033年中国 先进封装

第六节 2026-2033年中国 先进封装

第十三章 中国 先进封装

第一节 观研天下中国 先进封装

一、未来 先进封装

二、未来 先进封装

第二节 中国 先进封装

第三节 中国 先进封装

一、SWOT模型概述

二、行业优势

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国 先进封装

第四节 中国 先进封装

第五节 中国 先进封装

第六节 观研天下中国 先进封装

第十四章 中国 先进封装

第一节 中国 先进封装

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第二节 中国 先进封装

一、 先进封装

二、 先进封装

三、 先进封装

四、 先进封装

五、 先进封装

第三节 先进封装

一、 先进封装

二、 先进封装

三、 先进封装

四、 先进封装

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202607/807331.html>